

2017年2月1日

ウェーハ用ワイドエリア対応高速バンプボンダ SBB-5200 受注開始

株式会社新川（社長：長野高志、東京都武蔵村山市伊奈平二丁目 51 番地の 1）は、ウェーハ用ワイドエリア対応高速バンプボンダ「SBB-5200」の受注を開始しました。

来る IoT 時代では、ネット接続されるセンサーの数が 1 兆個になると見込まれています。各種センサーに組み込まれる、RF デバイス、水晶デバイス、MEMS などの電子部品生産向けとして、同機種を開発しました。ワイヤボンダ UTC-5000 をベースとして高速バンプボンディング（30ms/バンプ）を実現し、2 ウェーハステージ仕様に加え、昇降温制御機能を搭載することにより生産性を向上します。



【SBB-5200 の特長】

- (1) ウェーハ回転ステージにより、6 インチウェーハに対応
- (2) ウェーハステージに昇降温制御機能を搭載
- (3) 最大ボンド荷重 4.9N、ワイヤ径 $\phi 15 \sim 32 \mu\text{m}$ に対応
- (4) 当社独自の NRS 技術および RPS 技術の採用により、高精度なボンディングを実現

【高速バンプボンダ SBB-5200】

今後は、ウェーハオートローダーの搭載および8インチ（1ウェーハステージ）対応の開発を進めます。

■ その他当社取扱製品

ワイヤボンダ、ダイボンダ、フリップチップボンダ

■ お問い合わせ先

お客様お問い合わせ担当：グローバル営業統括部 佐藤 理（TEL：042-560-1225）

報道機関お問い合わせ担当：経営企画部 森 琢也（TEL：042-560-4848）

以上